

SAMPE JAPAN 会員各位殿

SAMPE Japan コンポジット委員会  
委員長 田那村武司

### コンポジット委員会 第 69 回研究会のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今回の研究会は、恒例になっております自動車用途コンポジットシンポジウムとして開催いたします。皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。

敬具

\*\*\*\*\*

## 第 11 回 自動車用途コンポジットシンポジウム

**主催** SAMPE Japan・コンポジット委員会, 日本材料学会・複合材料部門委員会, 同志社大学・先端複合材料研究センター

**開催日** 2019年11月15日(金) 10:15~19:00

**会場** 同志社大学(今出川校地)寒梅館地下 ハーディーホール, クローバーホール  
〒602-0023 京都市上京区烏丸上立売下ル

**参加費** 一般: 20,000円

共催・協賛会員: 10,000円

学生: 3,000円

テーブルトップ: 30,000円 (1名分のシンポジウム参加費用含む)

お支払方法: シンポジウム当日, 受付にて現金でお支払いをお願いします。

### <プログラム>

詳細は, 同志社大学・先端複合材料研究センターの HP をご覧下さい。

<http://rdccm.doshisha.ac.jp>

**開会挨拶 (10:15~10:20)**

シンポジウム実行委員長 田中和人(同志社大)

**<海外技術紹介(1)[JEC2019]> (10:20~11:20)**

GS-01 JEC2019: 熱可塑性複合材料技術の見どころ

山根正睦 (福井大学)

**<昼食> (11:20~12:00)**

**<ポスター:ショートオーラル・セッション> (12:00~13:30)**

[ 21 篇, ホームページ <http://rdccm.doshisha.ac.jp> に掲載]

<海外技術紹介(2)[K2019]> (13:30~15:30)

GS-02 K 2019 国際プラスチック・ゴム産業展における自動車用途コンポジット

田中和人 (同志社大学)

GS-03 K 2019 国際プラスチック・ゴム産業展における熱可塑 FRP の成形技術動向と適用事例

布谷勝彦 (金沢工業大学)

GS-04 K 2019 国際プラスチック・ゴム産業展における成形装置の動向

倉谷 泰成 ((株)KADO)

<休憩> (15:30~15:40)

<ポスターセッション> (15:40~16:30)

[ 21 篇, ホームページ <http://rdccm.doshisha.ac.jp> に掲載]

<一般講演> (16:30~17:20)

GS-05 高温高強度 ZrB<sub>2</sub>/B<sub>4</sub>C コンポジットの作製

○廣田健 (同志社大), Le Tung Duy, 加藤将樹, 湯浅元仁,  
宮本博之, 西村聡之 (物質・材料研究機構)

GS-06 オートクレーブ法を使わない新規成形法

○辻村豊 (播羊化学研究所), 鳥山倫靖 (MONOPOST)

閉会挨拶 (17:20~17:25)

先端複合材料研究センター長

田中達也(同志社大)

情報・名刺交換会 (17:30~19:00) Hamac de Paradis(アマーク・ド・パラディ) 寒梅館 1階カフェレストラン

<各種締め切り>

・テーブルトップ展示申込期限 (先着 5 社まで) : 2019 年 11 月 8 日 (金)

・シンポジウム・情報・名刺交換会参加申込締め切り : 2019 年 11 月 8 日 (金)

<各種問い合わせ先>

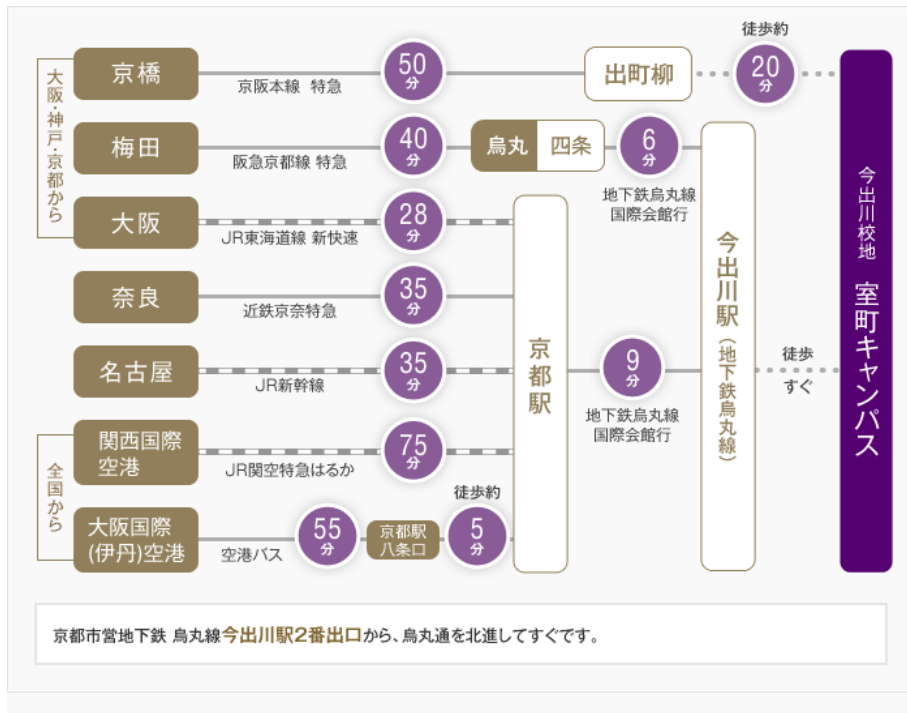
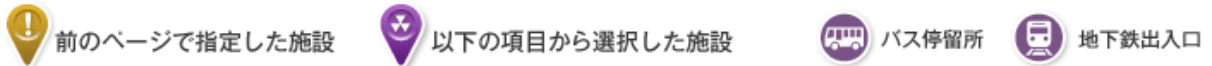
同志社大学・先端複合材料研究センター : rdccm@mail.doshisha.ac.jp

あるいは実行委員長 田中和人 : ktanaka@mail.doshisha.ac.jp

まで, ご連絡下さい。

【会場アクセス】

<http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/muromachi.html>





*Society for the Advancement of Material and Process Engineering*

先端材料技術協会

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-1-4F (株) ガリレオ内

Tel:03-5981-9824 Fax:03-5981-9852 E-mail:g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL:www.sampejapan.gr.jp

**お申し込み方法:E-mail あるいは fax にて下記の内容をご送付下さい.**

\*\*\*\*\*

## **第 11 回 自動車用途コンポジットシンポジウム 参加申込用紙**

同志社大学・先端複合材料研究センター事務局 行

E-mail: rdccm@mail.doshisha.ac.jp

FAX: 0774-65-6784

**シンポジウム・懇親会参加申込締め切り:2019 年 11 月 8 日(月)**

・第 11 回 自動車用途コンポジットシンポジウムに参加します.

・情報・名刺交換会(参加費は無料.)に【参加します. 参加しません.】

[いずれかを消して下さい]

会社名: 所属:

郵便番号: TEL:

住所: FAX:

氏名: E-mail: